

※本リリースは2026年2月17日に発表されたリリースを訳したものです

## タワーセミコンダクターとScintil Photonics、AIインフラ向け世界初の ヘテロジニアス統合型DWDMレーザーの提供開始を発表

*タワーのグローバル生産体制とScintil独自のSHIP™プラットフォームの融合により、  
次世代ハイパースケールAIインフラの厳しい要件に対応*

イスラエル ミグダル ハエメクおよびフランス グルノーブル、2026年2月17日 - 高付加価値アナログ半導体ソリューションのリーディングファウンドリである**タワーセミコンダクター**（NASDAQ/TASE: TSEM）と次世代 AI インフラ向けヘテロジニアス（異種）統合フォトニクス技術のリーダーである Scintil Photonics は本日、Scintil の SHIP™（Scintil Heterogeneous Integrated Photonics）技術を用いた、世界初となるヘテロジニアス統合型 DWDM レーザー光源の提供開始を発表しました。SHIP™は、タワーの量産向けシリコンフォトニクスプラットフォームとモノリシックレーザー光源の異種統合技術を組み合わせることで、AI 向け DWDM アプリケーションに求められる高度な技術要件に応えます。

DWDM レーザーは、次世代 AI インフラの中核となるコパッケージドオプティクス（CPO）において重要なコンポーネントです。CPO は、自律的な動作を行う「エージェント型 AI」時代に不可欠な GPU 利用率の向上とハイパースケーラーの投資対効果（ROI）改善を実現しつつ、増大し続ける帯域幅密度、超低テールレイテンシ（通信遅延の最大値）、およびビット当たりの消費エネルギー低減を達成することを目的としています。

650 Group, LLC 創設者兼テクノロジーアナリストの Alan Weckel 氏は次のように述べています。「サーバー間接続がマルチトラック CPO へと移行することで、スケールアップ・ネットワーキング（拡張ネットワーク）の機会は飛躍的に拡大しようとしています。市場が光アーキテクチャへ移行し、GPU/XPU あたりの I/O パッド面積（ビーチフロント）や銅配線による帯域幅の制約が軽減されるにつれ、スケールアップ・ネットワーキングは 2030 年に 2,000 億ドル規模と予測される AI ネットワーキング市場において、ますます大きなシェアを占めることになるでしょう。製造・ファウンドリからベンダーに至るまでの連携こそが、ハイパースケーラーが AI 分野における目標達成に必要な信頼性と供給量を実現し、CPO 市場成長を後押しする鍵となります。」

ScintilのSHIP™技術は、すでにタワーのシリコンフォトニクス・プラットフォーム上で検証されています。この技術を用いて製造された業界初のDWDM最適化インテリジェント統合レーザー光源が「LEAF Light™」です。タワーセミコンダクターが保有する複数にまたがるシリコンフォトニクス製造基盤は、ハイパースケール展開のニーズに合致した、回

復力のある生産能力と供給継続性を提供します。このパートナーシップにより、ハイパースケール領域での大規模量産展開に不可欠な生産の柔軟性と安定供給を実現する体制が整います。両社の協業は、DWDM CPOプログラムにおける顧客評価を支援し、認定から量産段階へと至る明確なロードマップを確立します。

Scintil Photonicsの最高経営責任者（CEO）であるマット・クロウリー氏は次のように述べています。「次世代のAIインフラには、1ファイバーあたりの帯域幅を拡大しながら、ビットあたりの消費電力を低減する光インターコネク트가求められています。DWDMコパッケージド・オプティクスはこの要件を満たす最適なソリューションです。LEAF Light™がDWDMレーザー光源技術を提供し、タワーのSiPhoプラットフォームが製造規模をもたらします。SHIP™がタワーの量産ラインで検証されたことで、お客様は評価段階から月産数百万ユニット規模の量産移行への明確なロードマップが示されました。」

タワーセミコンダクターのRF事業部門副社長兼ゼネラルマネージャーであるDr. Ed Preislerは次のように述べています。「当社はScintilとの長期的なパートナーシップを非常に重視しており、次世代のスケールアップ・アーキテクチャを実現するこの革新的なモノリシックDWDMレーザー技術を市場に提供できることを大変嬉しく思います。Scintilの技術は、当社が世界中の製造拠点で光トランシーバー向けに量産中のPH18Mプラットフォームを補完するものです。」

AIデータセンターの成長が加速する中、ハイパースケールは電力削減、利用率向上、そして次世代モデルへの拡張性を備えたネットワークソリューションを必要としています。業界は、より高い帯域幅密度、ビット当たりの低消費電力、超低テールレイテンシを実現するDWDM CPOへと向かっています。LEAF Light™は、ヘテロジニアス統合技術を用い、アクティブレーザーと確立されたシリコンフォトニクスを単一チップ上にモノリシックに統合した、初の量産対応DWDMレーザー光源です。

### **追加情報およびOFC：**

本製品およびScintilの製造ロードマップに関する詳細については、2026年3月17日～19日にロサンゼルスで開催される[OFC 2026 Conference](#)にて、Scintilブース（No.5537）までお越しください。

タワーの先進的なシリコンフォトニクス（SiPho）プラットフォームおよびRF・HPA技術ソリューションの詳細については、2026年3月17日～19日に開催される[OFC 2026 Conference](#)にて、タワーブース（No.2221）へお越しください。追加情報は当社ウェブサイト（[こちら](#)）でもご覧いただけます。

会期中は両社の担当者が来場者対応および個別面談に対応します。

## タワーセミコンダクターについて

タワーセミコンダクター株式会社(NASDAQ:TSEM,TASE:TSEM)は、高付加価値のアナログ半導体ソリューションのファンドリリーダーとして、コンシューマー、産業機械、車載用、モバイル、インフラ、医療用、航空宇宙・防衛などの成長市場で集積回路 (IC) の技術・開発・製造プラットフォームを提供しています。タワーセミコンダクターは、長期的なパートナーシップと先端の革新的なアナログテクノロジーの提供を通じて、意義あるサステナブルインパクトを創造することに注力し、SiGe、BiCMOS、ミックスドシグナル / CMOS、RF CMOS、CMOS イメージセンサ、non-imaging sensor、ディスプレイ、パワーマネジメント(BCD および 700V)、フォトニクス、MEMS など、カスタマイズが可能なプロセスプラットフォームを幅広く提供しています。また迅速かつ正確なデザインサイクルを実現する世界クラスの設計支援環境を提供し、IDM やファブレス企業向けにはプロセス移管サービスを提供しています。複数のファブを使ってサービスを提供するために、タワーセミコンダクターはイスラエルに 2 か所(150mm と 200mm)、米国に 2 か所(200mm)、またタワーセミコンダクターが 51%の株式を保有する日本の TPSCo に 2 か所(200mm と 300mm)の生産拠点を保有し、イタリアのアグラテでは 300mm 工場を ST と共有、またニューメキシコ州のインテルの 300mm工場でも生産が可能となっています。詳細は [www.towersemi.com](http://www.towersemi.com) をご覧ください。

### **Safe Harbor Regarding Forward-Looking Statements**

This press release includes forward-looking statements, which are subject to risks and uncertainties. Actual results may vary from those projected or implied by such forward-looking statements. A complete discussion of risks and uncertainties that may affect the accuracy of forward-looking statements included in this press release or which may otherwise affect Tower's business is included under the heading "Risk Factors" in Tower's most recent filings on Forms 20-F, F-3, F-4 and 6-K, as were filed with the Securities and Exchange Commission (the "SEC") and the Israel Securities Authority. Tower does not intend to update, and expressly disclaim any obligation to update, the information contained in this release.

**Tower Semiconductor Company Contact:** Orit Shahr | +972-74-7377440 | [oritsha@towersemi.com](mailto:oritsha@towersemi.com)

**Tower Semiconductor Investor Relations Contact:** Liat Avraham | +972-4-6506154 | [liatavra@towersemi.com](mailto:liatavra@towersemi.com)

### **About Scintil Photonics**

Scintil Photonics is the global leader in DWDM laser sources for AI. Using its SHIP™ (Scintil Heterogeneous Integrated Photonics) technology, Scintil developed LEAF Light™, the world's first single-chip DWDM laser source for high-density optical connectivity in scale-up networks. LEAF Light™ enables hyperscalers to meet the power, tail latency, utilization, and bandwidth demands of large-scale GPU clusters, leveraging next-generation co-packaged optics (CPO).

Headquartered in Grenoble, France, with operations across North America, Scintil is built to support global needs for advanced AI infrastructure.

[www.scintil-photonics.com](http://www.scintil-photonics.com)

**Scintil Media Contact:** Isaac Lopez | OmniScale Media (For Scintil Photonics) | 360-576-5475 | [isaac@omniscalemedia.com](mailto:isaac@omniscalemedia.com) or  
For press inquiries in France or Europe, please contact [cassandra@scintil-photonics.com](mailto:cassandra@scintil-photonics.com).